



# 帛江科技股份有限公司

BO-JIANG TECHNOLOGY CO., LTD.

## PRODUCT SPECIFICATION (產品規格書)

**BO-JIANG**

PART NO.(圖號)	9765NS502BD000B	DATE (日期)	2009 / 09 / 22
TITLE(產品名稱)	MMCX PCB MOUNT JACK		

### MATERIAL AND FINISH(材質及表面處理)

DESCRIPTION(名稱)	MATERIAL(材質)	FINISH(表面處理)
Center Contact(中心導體)	BERYLLIUM COPPER	30 μ" GOLD
Insulator(絕緣體)	TEFLON	WHITE
Outer Contact(外導體)	BRASS	3 μ" GOLD
Others(其它)		

### ELECTRICAL(電氣特性)

項目	測試條件	測試規格
Impedance(阻抗)	0 ~ 6 GHz	50 Ω
Voltage Standing Wave Ratio(VSWR)(駐波比)	0 ~ 6 GHz	1.3 Max.
Dielectric Withstanding Voltage(絕緣耐電壓)	DC , time: 60sec	500 Vrms Min.
Contact Resistance (導體阻抗)	Center Contact (中心導體)	DC 0.2V, 1A 5 mΩ Max.
	Outer Contact(外導體)	DC 0.2V, 1A 2.5 mΩ Max.
Insulation Resistance(絕緣阻抗)	DC 500V, time: 60sec	1000 MΩ Min.

### MECHANICAL(機械特性)

項目	測試條件	測試規格
Force To Engage/Disengage(接合力/脫離力):	N/A	1.4 lbs.~ 8 lbs.
Contact Retention(中心導體承受力):	60mm/min	2 lbs. min.(從界面推)

### REMARKS(備註)

- Between BODY (NO.1) And INSULATOR (NO.2) Must Withstand A 2 lbs. Min. Pull Force. (拉力測試)。



B	新增備註 1	<i>Mark</i>	<i>Mark</i>	Alicia
A	N/A	Mark	Mark	Alicia
Issue 版本	Revision 修改記錄	Approved 核准	Checked 審核	Drawn 製定